

2022 年第三代半导体材料技术与市场研讨会

半导体材料是信息技术的核心基础材料，一代材料、一代技术、一代产业，从基础技术层面支撑了信息技术翻天覆地的变化，推动了电子信息科技产业可持续蓬勃发展。经历了数代的更迭，以碳化硅（SiC）及氮化镓（GaN）为代表的第三代半导体，由于其优异的性能表现，逐步受到市场的关注，是我国“十四五规划”以及“2035 远景目标”的重要发展方向，也是支撑新一代移动通信、智能电网、高速轨道交通、新能源汽车、消费类电子等领域等重点领域发展的核心材料。

GaN 和 SiC 在材料性能上各有优劣，因此在应用领域上各有侧重和互补。碳化硅功率器件以其优异的耐高压、耐高温、低损耗等性能，在新能源汽车、光伏发电、轨道交通、智能电网等领域具有明显优势；氮化镓功率器件具备带隙大、绝缘破坏电场大及饱和速度大等性能，主要应用领域为 LED、激光器、5G 和快充等。第三代半导体材料快速推广应用，正在掀起一场节能减排和新能源领域的巨大变革。

为了促进第三代半导体材料领域的相互交流与合作，半导体在线将于 2022 年 8 月 12 日在江苏苏州组织召开 2022 年第三代半导体材料技术与市场研讨会，旨在提供协同创新的高质量交流平台，推动国内第三代半导体材料的学术研究、技术进步和产业发展。

一、 主办单位

半导体在线

二、时间和地点

时间：2022 年 8 月 12 日（8 月 11 日签到）

地点：江苏苏州市吴中区郭巷街道环湖路 1688 号

苏州阳光城希尔顿酒店

三、会议议题

SiC、GaN 等生长与外延技术

SiC、GaN 等生长装备和其他装备

SiC、GaN 等器件及测试分析技术

SiC、GaN 等器件封装模块、系统解决方案及应用

四、会议形式

主要通过主题发言、现场讨论的形式，也欢迎材料企业、设备企业安排小型展览。会议期间还将组织演讲嘉宾或行业资深专家们与参会代表互动进行自由讨论。为了共同办好这次会议，热烈欢迎各企业、科研院所赞助本次会议，并借此机会提高知名度。

五、会议注册费用

会议注册费：（仅含会议期间提供午、晚餐及茶歇、会议资料）

注册类别	提前注册(8 月 8 日前)	之后/现场(8 月 9 日后)
一般代表	2500 元/人	3000 元/人
学生代表	1800 元/人	2300 元/人



账户信息

户名：石墨邦（北京）互动科技有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区宏达北路支行

账号：0200059009200333671

付款时注明：单位名称+参会人名

开票注意事项：

增值税普通发票请提供单位名称及税号。

如果需要增值税专用发票，请提供单位名称、税号、地址、电话、开户行、账号。接收邮箱：bandaotibj@163.com

六、住宿安排

苏州阳光城希尔顿酒店（五星级）

订房电话：18513072168（秦经理）

住宿标准：单间/标间 协议价 480 元/间（含早）

七、组委会联系方式

参会、参展、宣传及赞助事宜

联系人：刘经理

联系电话：13521337845（微信同号）

联系人：秦经理

联系电话：18513072168（微信同号）

石墨邦（北京）互动科技有限公司

2022年7月13日

